

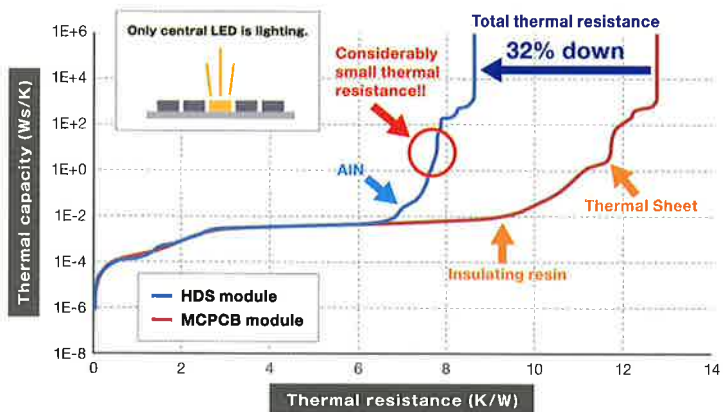
# HDS

HDS (Heat Sink Direct Bonded DBA Substrate)

- ハイブリッドカーのパワーモジュールに使われる当社のDBA基板技術とヒートシンク一体接合技術を用いた高信頼性・低熱抵抗のLEDモジュールです。
- DBA基板の高信頼性に加え、ヒートシンクを基板に「直接接合」しているため、極めて熱抵抗の低いモジュールを実現しました。

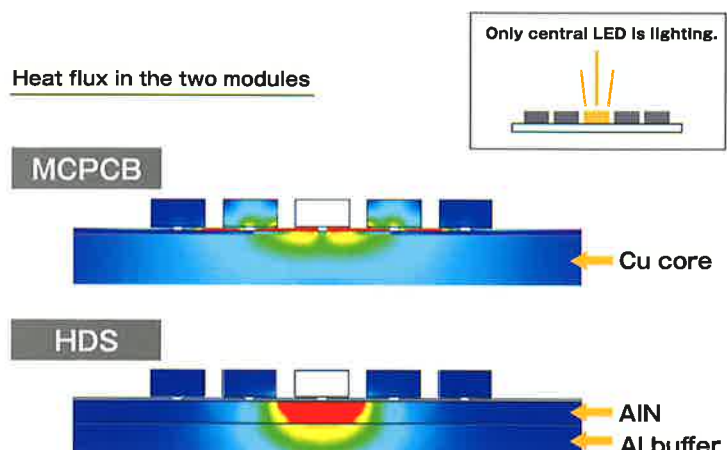
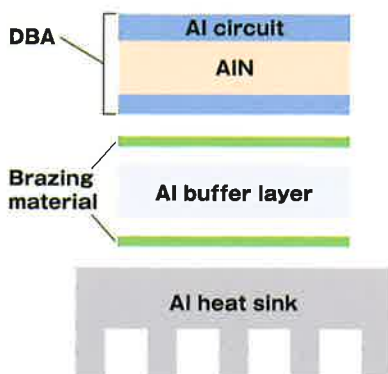
## メリット

- 1 ヒートシンクを直接接合したDBA基板
- 2 圧倒的な低熱抵抗、高信頼性
- 3 LEDヘッドランプの小型ハイパワー化に最適



## 技術のポイント

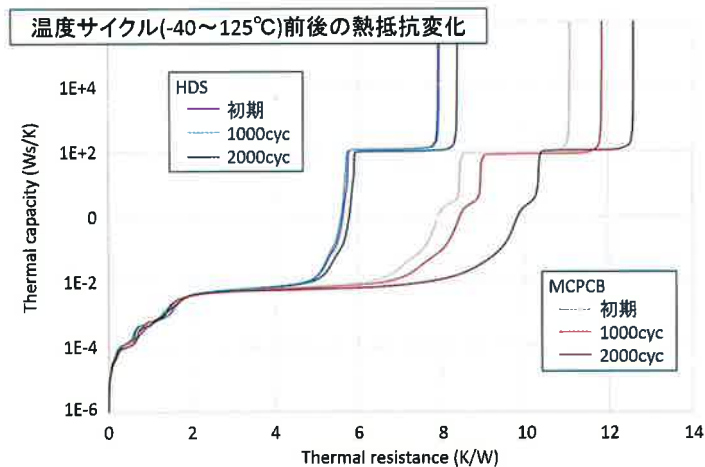
- 1 ハイブリッドカーで圧倒的なシェアの当社DBA基板にヒートシンクを直接接合し理想的な構造を実現
- 2 素子同士の熱干渉が非常に小さく、ダイレクトに放熱



**仕様**

|         | 入力W | 搭載LED例        | T <sub>J</sub> (°C) | 熱抵抗(K/W) | DBAサイズ(mm <sup>2</sup> ) | HS材質  |
|---------|-----|---------------|---------------------|----------|--------------------------|-------|
| HDS-Φ38 | 12W | CSPタイプ3(W)×4個 | 58.5                | 4.7      | 13X13                    | A6063 |
| HDS-Φ70 | 15W | CSPタイプ3(W)×5個 | 42.7                | 2.1      | 20X10                    | A6063 |

条件: 雰囲気温度20°C自然対流、CSPはOSLON Compact CL(OSRAM)

**温度サイクル信頼性**

**熱干渉特性**
